

OBSAH

	SEZNAM NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK	9
	PŘEDMLUVA	13
1.	LITOGRAFIE A TVORBA RELIÉFU A PŘÍKLADY JEJICH TECHNOLOGICKÝCH APLIKACÍ	17
1.1	Úvod	17
1.2	Polygrafie a reprodukční technika	17
1.3	Elektronika a mikroelektronika	21
1.4	Soudobé trendy vývoje litografie a litografických materiálů	32
1.5	Literatura	36
2.	FYZIKÁLNÍ A FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ ZÁKLADY LITOGRAFICKÝCH TECHNIK A PROCESŮ	39
2.1	Světelné záření a fotolitografie	39
2.1.1	Kontaktní metoda	39
2.1.2	Bezkontaktní metoda	41
2.1.3	Projekční metoda	42
2.1.4	Fyzikální limity optického způsobu záznamu	44
2.1.4.1	Koherence světla	44
2.1.4.2	Tvorba obrazu	45
2.1.4.3	Difrakce světla	47
2.1.4.4	Numerická apertura	51
2.1.4.5	Funkce přenosu kontrastu	53
2.1.4.6	Vliv vlnové délky světla	57
2.1.4.7	Hloubka ostrosti	57
2.1.4.8	Vliv stojatého vlnění	58
2.1.5	Závěr	60
2.2	Elektronové záření a elektronová litografie	61
2.2.1	Skenovací systémy	63
2.2.2	Projekční systémy	66
2.2.3	Funkční prvky elektronových litografů	67
2.3	Rentgenové záření a rentgenová litografie	71
2.3.1	Masky pro rentgenovou litografii	73
2.3.2	Praktické aspekty rentgenové litografie	74
2.4	Iontová litografie	77
2.5	Hybridní litografie	78
2.6	Vedlejší účinky radiačního záření	79

2.7	Technologické procesy	70
2.7.1	Vliv čistoty podložky	89
2.7.2	Ovrstvování podložky rezistem	82
2.7.3	Předexpoziční ohřev (předtvrzení)	86
2.7.4	Expozice	89
2.7.4.1	Zdroje ultrafialového záření	89
2.7.4.2	Litografická citlivost	91
2.7.4.3	Stanovení optimálního expozičního času	92
2.7.4.4	Modelování expozice ve fotolitografii	96
2.7.5	Vyvolávání	103
2.7.6	Dotvrzování	108
2.7.7	Leptání	109
2.7.8	Odstraňování rezistu	111
2.7.9	Stabilita a čistota roztoků rezistů	111
2.7.10	Problematika adheze rezistů k podložce	112
2.8	Literatura	115
3.	INTERAKCE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ S ATOMY, MOLEKULAMI A POLYMERY	120
3.1	Šíření záření ve hmotě	120
3.1.1	Elektronové záření	120
3.1.2	Elektromagnetické záření	122
3.1.3	Lineární ztráta energie (LET)	123
3.1.4	Veličiny charakterizující absorpci energie ionizujícího záření v látce	123
3.1.5	Zdroje ionizujícího záření	124
3.2	Způsoby přenosu energie ionizujícího záření na ozařovanou hmotu a jeho důsledky	125
3.2.1	Nábojový přenos energie	125
3.2.2	Excitační přenos energie	126
3.2.3	Závislost přenosu energie na energii záření	127
3.2.4	Reakce v tuhé fázi	128
3.3	Mechanismus interakcí ionizujícího záření s polymery	130
3.3.1	Dienové polymery	130
3.3.2	Polyakryláty a polymethakryláty	133
3.3.3	Polyolefiny a polyolefínsulfony	138
3.3.4	Aromatické polymery	140
3.3.5	Oxidační procesy při ozařování polymerů	140
3.4	Popis sířovacích a degračních reakcí polymerů	141
3.4.1	Degradace polymerních molekul	142
3.4.1.1	Degradační účinnost	143
3.4.2	Sířování polymerních molekul	144
3.4.2.1	Bod gelace a systém za bodem gelace	145
3.4.2.2	Sířovací účinnost	147
3.5	Parametry ovlivňující citlivost polymerů k ionizujícímu záření	149
3.6	Literatura	155

4.	REZISTY PRO TECHNOLOGICKÉ APLIKACE	160
4.1	Elektronové a rentgenové rezisty	160
4.1.1	Distribuce energie elektronů ve vrstvě polymeru	160
4.1.2	Metody hodnocení elektronových a rentgenových rezistů	169
4.2	Materiály pro elektronové rezisty	178
4.2.1	Negativní elektronové rezisty	179
4.2.2	Pozitivní elektronové rezisty	196
4.2.3	Rentgenové rezisty	206
4.2.4	Anorganické rezisty	207
4.3	Pozitivní fotorezisty	208
4.3.1	Systémy s hydrofobní světlocitlivou přísadou	209
4.3.1.1	Diazochinon a polymer rozpustný v zásadách	209
4.3.1.1.1	Detailní struktura, fotolýza a tepelné chování diazonaftochinonů	209
4.3.1.1.2	Základní komponenty fotorezistů	217
4.3.1.1.3	Modifikace polymerní složky fotorezistů	220
4.3.1.1.4	Metody zlepšení vlastností směsí	222
4.3.1.2	Směsné systémy s katalyzovanou hydrolyzou	230
4.3.1.3	Směsné fotooxidační systémy	231
4.3.2	Systémy založené na přeměnách polymerů	232
4.3.2.1	Systémy založené na hydrolyze polymeru	232
4.3.2.2	Systémy založené na fotolýze <i>o</i> -nitrobenzylových skupin	233
4.3.2.2.1	Systémy založené na přeměnách bočních řetězců polymeru	233
4.3.2.2.2	Systémy založené na přeměnách hlavních řetězců polymeru	234
4.3.2.2.3	Jiné způsoby přeměn	235
4.4	Negativní fotorezisty	236
4.4.1	Světlocitlivé směsi na bázi diazoniových solí	236
4.4.1.1	Diazoniové soli	236
4.4.1.2	Diazoniové pryskyřice	238
4.4.2	Fotorezisty na bázi azidů	248
4.4.2.1	Fotochemické vlastnosti arylazidů	249
4.4.2.2	Systémy s diazidy rozpustnými v organických rozpouštědlech	256
4.4.2.3	Arylazidy rozpustné ve vodě	265
4.4.2.4	Fotorezisty na bázi azidopolymerů	268
4.4.3	Fotorezisty na bázi polyvinylcinnamátů a jiných cyklo-dimerujících systémů	273
4.4.3.1	Cyklo-dimerující systémy	284
4.5	Fotorezisty pro speciální aplikace	290
4.5.1	Fotorezisty pro krátkovlnné ultrafialové světlo	290
4.5.1.1	Pozitivní fotorezisty	290
4.5.1.2	Negativní fotorezisty	300
4.5.2	Tepelně stálé fotorezisty	301
4.5.3	Fotorezisty pro suché vyvolávání	307
4.5.4	Difúzní fotorezisty	310
4.5.5	Systémy pro mechanický přenos reliéfního zobrazení	316
4.5.6	Světlocitlivé vrstvy pro suchý ofset	322

4.5.7	Světlocitlivé vrstvy vytvrzované Lewisovými a Brönstedovými kyselinami	331
4.6	Literatura	344
5.	SPECIÁLNÍ LITOGRAFICKÉ TECHNIKY A MATERIÁLY	357
5.1	Litografické systémy s vícevrstevnými rezisty (MLR)	357
5.1.1	Praktické provádění techniky MLR	366
5.1.2	Zhodnocení soudobých MLR	368
5.2	Plazmatický lept	369
5.3	Suchá mikrolitografie	374
5.4	Soudobé komerční rezisty	376
5.4.1	Hodnocení vlastností rezistů	376
5.4.2	Tabelární přehled	378
5.5	Literatura	400
	ZKRATKY PLASTŮ A SPECIÁLNÍ OZNAČENÍ	404
	REJSTRÍK	405